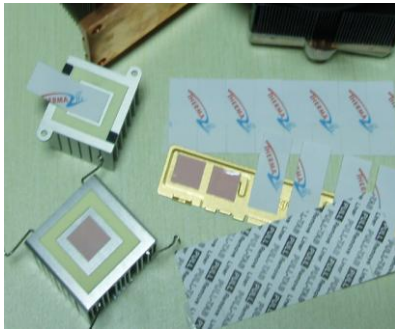


TIC™800K系列產品是一種在聚酰亞胺薄膜上塗佈陶瓷混合填充相低熔點材料的高熱傳導性及高介電常數的絕緣墊片。

在溫度50℃，TIC™800K表面開始軟化並流動，填充散熱片和積體電路板的接觸介面上細微不規則間隙，以達到減小熱阻的目的。



特性

- 》表面較柔軟，良好的導熱率
- 》良好傳導率，良好電介質強度
- 》高壓絕緣，低熱阻
- 》抗撕裂，抗穿刺

應用

- 》電力轉換設備
- 》功率半導體器件：
T0 集成塊，MOSFETs & IGBTs
- 》視聽產品
- 》汽車控制裝置
- 》電動機控制設備
- 》普通高壓接合面

TIC™800K系列特性表

產品名稱	TIC™805K	TIC™806K	TIC™808K	Test Method
顏色	淡琥珀色			Visual
複合厚度	0.004"/0.102mm	0.005"/0.127mm	0.006"/0.152mm	ASTM D374
聚酰亞胺薄膜厚度	0.001"/0.025mm	0.001"/0.025mm	0.002"/0.050mm	ASTM D374
總厚度	0.005"/0.127mm	0.006"/0.152mm	0.008"/0.203mm	ASTM D374
比重	2.0 g/cc			ASTM D297
熱容積	1 l/g-K			ASTM C351
抗張強度	>13.5 Kpsi	>13.5 Kpsi	>13.5Kpsi	ASTM D412
使用溫度範圍	(-58 to 266°F) / (-50 to 130°C)			***
電性				
擊穿電壓	>4000 VAC	>4000 VAC	>5000 VAC	ASTM D149
介電常數	1.8 MHz			ASTM D150
體積電阻率	3.5X10 ¹⁴ Ohm-meter			ASTM D257
導熱性				
熱傳導率	1.6 W/m-K			ASTM D5470
熱阻抗 @50psi	0.12°C-in ²W	0.13°C-in ²W	0.16°C-in ²W	ASTM D5470

標準厚度:

0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm) 0.08"(0.203mm) 如需不同厚度請與本公司聯繫。

標準尺寸:

10" x 100"(254mm x 30.48M) TIC™800K 系列可模切成不同形狀提供。

壓敏黏合劑:

壓敏黏合劑不適用於TIC™800K 系列產品。

補強材料:

TIC™800K系列板材代聚酰亞胺薄膜為補強。



導熱硅膠片 | 相變化材料 | 導熱矽膠布 | 導熱膏 | 導熱雙面膠 | 導熱塑料 | 導熱灌封膠 | RTV硅膠 | 陶瓷散熱片 | 石墨片 | 導熱粘著劑

加拿大 Canada:
TEL: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com
[Http://www.thermazig.com](http://www.thermazig.com)

台灣 Taiwan:
TEL: +886-2-22771007
E-mail: sales@ziitek.com.tw
[Http://www.ziitek.com.tw](http://www.ziitek.com.tw)

東莞 Dongguan:
TEL: +86-769-38801208
E-mail: sales@ziitek.com
[Http://www.ziitek.com](http://www.ziitek.com)

昆山 Kunshan:
TEL: +86-512-57816297
E-mail: sales@ziitek.com

成都 Chengdu:
TEL: +86-28-62379168
E-mail: sales@ziitek.com